

次世代半導体パッケージのコンソーシアム「US-JOINT」に 3M が参画

株式会社レゾナック（社長：高橋秀仁、以下 当社）が中心となり設立した、次世代半導体パッケージのコンソーシアム US-JOINT^{※1}に、米国の化学メーカーの 3M Company（本社：米国ミネソタ州、以下 3M）が新たに参画しました。これにより US-JOINT は日米 12 社によるコンソーシアムになります。3M が持つ 50 以上の技術プラットフォームにわたる数十年の材料科学の専門知識を活用することで、次世代半導体パッケージの研究開発がさらに加速します。

急速に需要が拡大している AI 向けなどの次世代半導体は、2.5D や 3D^{※2}などの最先端のパッケージング技術により、さらなる高性能化が進んでいます。近年では、半導体メーカーに加え、GAFAM をはじめとした大手テック企業やファブレス企業が半導体パッケージの最新コンセプトを生み出しています。US-JOINT はこれらの企業と共に、半導体パッケージの最新コンセプトの検証を行います。シリコンバレーに研究開発拠点を設け、クリーンルームや製造装置を導入して 2025 年内の稼働を予定しております。

今後も当社は US-JOINT と共に、半導体の進化を支える最先端のパッケージング技術を研究開発してまいります。



※1 US-JOINT プレスリリース URL : <https://www.resonac.com/jp/news/2024/07/08/3118.html>

※2 2.5D は複数のチップをインターポザーと呼ばれるシリコン基板上に実装する技術。3D は複数のチップを積層する技術。

以上

【Resonac（レゾナック）グループについて】

レゾナックグループは、2023年1月に昭和電工グループと昭和電工マテリアルズグループ（旧日立化成グループ）が統合してできた新会社です。半導体・電子材料の売上高は、約3,400億円に上り、特に半導体の「後工程」材料では世界 No.1 の企業です。2社統合により、材料の機能設計はもちろん、自社内で原料にまでさかのぼって開発を進めています。新社名の「Resonac」は、英語の「RESONATE：共鳴する・響き渡る」と、Chemistry の「C」の組み合わせです。今後さらに共創プラットフォームを生かし、国内外の半導体メーカー、材料・装置メーカーとともに技術革新を加速させます。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

株式会社レゾナック・ホールディングス <https://www.resonac.com/jp/>

【3M について】

3M（本社：米国ミネソタ州）は、サイエンス（科学）が明るい未来を創造すると信じています。人びと、アイデア、サイエンスの力を解き放つことによりさらなる可能性を模索し、世界中の社員がお客様、地域社会、そして地球の課題を解決するために取り組んでいます。人びとの暮らしを豊かにし、「これから」を創り出すための3Mの活動は [3M.com/news](https://www.3m.com/news) をご覧ください。

◆ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社レゾナック・ホールディングス

ブランド・コミュニケーション部 メディアリレーショングループ

TEL 03-6263-8002